菱生精密工業股份有限公司

2022年第三季
法人說明會

NOV.22 ,2022

免責聲明

- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

議 程

- 營運成果
- 營運展望
- Q & A

營運成果

Best Partner
Assembly
Testing
Semiconductor Technology Services

2022年合併綜合損益表

(與去年同期比較)

單位：新台幣佰萬元

科　目	2022年前三季		2021年前三季		YoY	
	$	%	$	%	$	%
營業收入淨額	4,770	100.0	5,766	100.0	(996)	(17.3)
營業毛利	535	11.2	1,091	18.9	(556)	(51.0)
營業費用	377	7.9	441	7.6	(64)	(14.5)
營業淨利	158	3.3	650	11.3	(492)	(75.7)
營業外收入及支出	84	1.8	131	2.3	(47)	(35.9)
稅前淨利	242	5.1	781	13.5	(539)	(69.0)
所得稅費用	(39)	(0.8)	(149)	(2.6)	110	(73.8)
本期淨利	203	4.3	632	11.0	(429)	(67.9)
EPS(新台幣元)	0.52		1.59			

(財務資料經會計師核閱)

2022年合併綜合損益表

(與前一季比較)

單位：新台幣佰萬元

科　目	2022/Q3		2022/Q2		QOQ	
	$	%	$	%	$	%
營業收入淨額	1,358	100.0	1,649	100.0	(291)	(17.6)
營業毛利	32	2.4	218	13.2	(186)	(85.3)
營業費用	110	8.1	138	8.4	(28)	(20.3)
營業淨利(損)	(78)	(5.7)	80	4.9	(158)	
營業外收入及支出	38	2.8	23	1.4	15	65.2
稅前淨利(損)	(40)	(2.9)	103	6.2	(143)	
所得稅利益(費用)	4	0.3	(6)	(0.4)	10	
本期淨利(損)	(36)	(2.7)	97	5.9	(133)	
EPS(新台幣元)	(0.08)		0.25			

(財務資料經會計師核閱)

2022年第三季合併簡明資產負債表/現金流量資訊

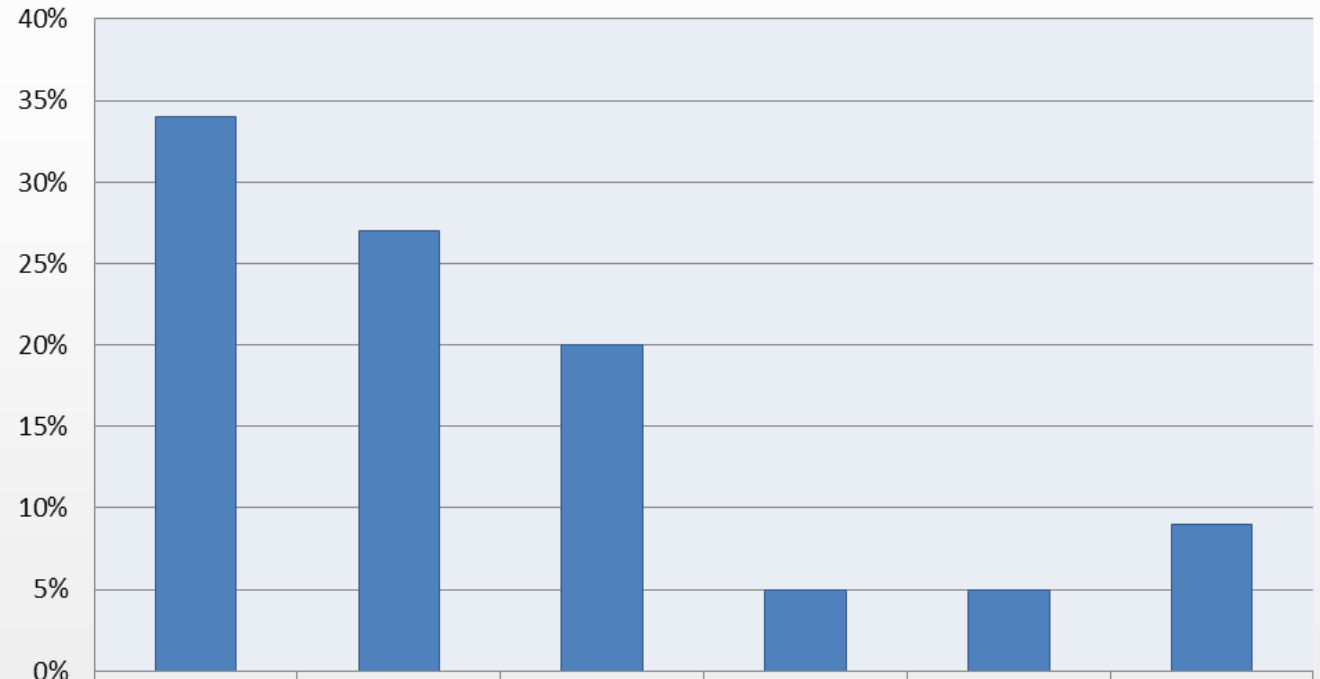
單位：新台幣佰萬元

科　目	2022/9/30		2021/12/31	
	$	%	$	%
現金及約當現金	1,357	15.5	1,647	17.5
應收帳款(淨額)	1,170	13.3	1,744	18.5
存貨(淨額)	653	7.5	690	7.3
固定資產	4,310	49.2	3,985	42.3
總資產	8,769	100.0	9,425	100.0
短期借款	596	6.8	666	7.1
長期借款	1,083	12.4	931	9.9
總負債	2,908	33.2	3,327	35.3
股東權益(含非控制權益)	5,861	66.8	6,097	64.7
每股淨值(新台幣元)	14.98		15.72	
	2022前三季		2021前三季	
折舊與攤銷	563		581	
資本支出	732		1,062	
營業活動淨現金流入	787		705	

(財務資料經會計師核閱)

封裝產品應用分析(母公司)

封裝產品應用比例%



產品應用類型	Sensor IC	NOR-flash / NAND-flash	Power IC	RF-IC	MCU	Others
	34%	27%	20%	5%	5%	9%

營運展望

Best Partner
Assembly
Testing
Semiconductor Technology Services

營運展望

■整體市況

–疫情、戰爭及通膨，影響全球總體經濟

–電子終端需求滑落，衝擊產業營收成長

■營運展望

–配合供應鏈庫存去化調整，保守經營

–縮減資本支出，嚴格控制各項成本及費用

–隨著行動裝置和車用需求，調整產品組合，著重感測元件及車用IC 封裝

Q & A

Best Partner
Assembly
Testing
Semiconductor Technology Services

Thank you

https://www.lingsen.com.tw